# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-156523

\_\_\_\_\_

(43)Date of publication of application: 20.06.1995

(51)Int.CI.

B41M 1/06

B41M 1/34

(21)Application number : 05-307963

(71)Applicant: KIN YOSHA KK

(22)Date of filing: 08.12.1993 (72)Inventor: KONUKI AKIO

YAMAOKI HIROMASA

### (54) OFFSET PRINTING METHOD

## (57)Abstract:

PURPOSE: To enhance a transfer printing performance by a method wherein an ink temperature is kept high in an ink accepting process for a good ink acceptability and, on the contrary, an ink temperature is kept low in a succeeding transfer process for the perfect transfer even in a solvent-free state.

CONSTITUTION: Ink 3 and an intaglio printing plate 1 are each kept at a temperature of, for example, 60° C. The cohesive force of the ink is set to be smaller than the interfacial tension of a silicone rubber and the ink. The ink 3 is loaded in the intaglio printing plate 1. An excessive ink 3 is scraped off by a doctor knife. The ink is accepted by a silicone rubber blanket 2. On the other hand, a glass plate 4 to be printed is kept at a temperature of approximately 15-20° C. The cohesive force of the ink is set to be larger than the interfacial tension of the silicone rubber and the ink. On the glass plate 4, a printing pressure of, for example, 0.4mm is applied to the silicone rubber blanket 2 with the ink 3





accepted for the transfer of 100% of the ink 3 onto the glass plate 4. The glass plate 4 printed in this manner is heated in an oven for curing the printed part.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.01.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3181164

20.04.2001

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

 $\mathbf{F}$  I

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-156523

(43)公開日 平成7年(1995)6月20日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

B 4 1 M 1/06

8808-2H

1/34

8808-2H

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-307963

(71)出頭人 000142436

株式会社金陽社

(22)出願日

平成5年(1993)12月8日

東京都品川区大崎1丁目3番24号

(72)発明者 小貫 昭男

東京都品川区大崎1丁目3番24号 株式会

社金陽社内

(72)発明者 山沖 弘政

東京都品川区大崎1丁目3番24号 株式会

社金陽社内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

## (54)【発明の名称】 オフセット印刷方法

### (57)【要約】

【目的】この発明は、版からシリコーンゴムブランケットへのインキの受理を良くし、シリコーンゴムブランケットからガラス等の基盤へのインキの100%転移印刷を行えることを主要な目的とする。

【構成】版からシリコーンゴムブランケットを介してガラス等の基盤にインキを印刷するオフセット印刷方法において、版からゴムブランケットにインキを受理する時にはインキの凝集力をシリコーンゴムとインキの界面張力より小さくし、ゴムブランケットから基盤にインキを転移する時にはインキの凝集力をシリコーンゴムとインキの界面張力より大きくすることを特徴とするオフセット印刷方法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 版からシリコーンゴムブランケットを介 してガラス等の基盤にインキを印刷するオフセット印刷 方法において、版からゴムブランケットにインキを受理 する時にはインキの凝集力をシリコーンゴムとインキの 界面張力より小さくし、ゴムブランケットから基盤にイ ンキを転移する時にはインキの凝集力をシリコーンゴム とインキの界面張力より大きくすることを特徴とするオ フセット印刷方法。

1

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明はオフセット印刷方法に 関し、特にカラー表示ディスプレー用カラーフィルター のストライプ及びマスクパターン等の微細パターンをガ ラス等の基盤上にインキを100%転移させるオフセッ ト印刷方法に関する。

### [0002]

【従来の技術】従来、カラー表示液晶ディスプレー用カ ラーフィルターのストライプ及びマスクバターンの印刷 においては、版から印刷用ゴムブランケットにインキを 20 受理させ、ガラス等の基盤上にオフセット印刷させる方 法を採っている。この場合、ガラス等の基盤にインキを 転移する方法として部分転移と100%転移の方法が知 られている。

【0003】この内一般的に行われている100%転移 の方法として、ブランケット表面ゴムをシリコーンゴム にしてインキとの剥離性を良くして100%転移の方法 を採っている。そして、インキの手法としてインキ中に シリコーンゴムに溶解しやすい溶剤を加え、インキ中の ム界面の界面張力を低下させてシリコーンゴムからイン キを剥離しやすくし、シリコーンゴムブランケットから ガラス等の基盤上に100%転移させる方法を採ってい る。とのようなインキ中に溶剤を入れた溶剤型インキは . 100%転移をさせる上では非常に効果のある手法であ

【0004】しかし、長時間印刷をしていると溶剤でシ リコーンゴムが膨潤してインキの受理、転移が段々悪く なり、またストライプの線がヘビ腹の形になったり、直 線性が悪くなったりの現象が起こる。その結果、液晶デ ィスプレーに組込んで作動させた時にコントラスト、画 質の低下の原因となる。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】このように、溶剤型イ ンキを使用した場合、この印刷の目的であるシリコーン ゴムブランケットからガラス等の基盤にインキを100 %転移する手段として、印刷の初期段階は良い結果を出 す。しかし、長時間印刷をすると凹版からシリコーンゴ ムブランケットへのインキの受理、またはシリコーンゴ ムブランケットからガラス等へのインキの転移が悪くな 50 る。なお、図2の符番4はガラス基盤を示す。

り、ストライプの直線性やストライプがヘビ腹の形にな る。その結果、液晶ディスプレーに組込んで作動した時 にコントラスト、画質の低下の原因となる。

【0006】との現象を解決するためには、インキ中の シリコーンゴムブランケットを膨潤させる溶剤を添加し ないか、シリコーンゴムに対して膨潤しない溶剤を添加 することである。しかし、このような手法を採ると、シ リコーンゴムブランケットからガラス等の基盤にインキ が100%転移しにくくなる。

10 【0007】 この原因は、シリコーンゴムとインキの界 面でインキ中の溶剤がシリコーンゴムに移行してシリコ ーンゴムの表面張力を小さくしてインキを100%転移 している方法を採っているので、インキを無溶剤又は、 シリコーンゴムが膨潤しない溶剤を添加した場合、シリ コーンゴムとインキの界面での界面張力の変化が無く、 インキの100%転移が出来なくなることにある。ま た、無溶剤インキの場合、インキの凝集力がシリコーン ゴムとインキの界面張力より強いため、凹版からシリコ ーンゴムブランケットの受理が非常に悪くなる。

【0008】この発明はこうした事情を考慮してなされ たもので、長時間の印刷に対応できる無溶剤又はシリコ ーンゴムが膨潤しずらい溶剤を添加して、凹版からシリ コーンゴムブランケットへのインキの受理を良くし、シ リコーンゴムブランケットからガラス等の基盤へのイン キの100%転移印刷を行えるオフセット印刷方法を提 供することを目的とする。

### [0009]

【課題を解決するための手段】この発明は、版からシリ コーンゴムブランケットを介してガラス等の基盤にイン 溶剤をシリコーンゴムに溶解させインキとシリコーンゴ 30 キを印刷するオフセット印刷方法において、版からゴム ブランケットにインキを受理する時にはインキの凝集力 をシリコーンゴムとインキの界面張力より小さくし、ゴ ムブランケットから基盤にインキを転移する時にはイン キの凝集力をシリコーンゴムとインキの界面張力より大 きくするととを特徴とするオフセット印刷方法である。 【0010】無溶剤又はシリコーンゴムに溶解しにくい 溶剤を添加してインキの100%転移印刷を行うために は、まず凹版からシリコーンゴムブランケットにインキ を受理する工程でインキの凝集力がシリコーンゴムとイ ンキの界面張力より小さくなっていなければ、インキが シリコーンゴムブランケットに受理されない。そこで、 インキの温度特性を考え、インキが髙温になるとインキ 粘度が低下することを利用してインキの凝集力を小さく することによって、凹版1からシリコーンゴムブランケ ット2へのインキ3の受理を必要十分にすることができ る(図1参照)。なお、図1はインキ3の凝集力がシリ コーンゴムとインキ3の界面張力より大きい場合である が、逆にインキ3の凝集力がシリコーンゴムとインキ3 の界面張力より小さい場合には、図2に示すようにな

3

【0011】次の工程のシリコーンゴムブランケット2に受理されたインキ3をガラス等の基盤(ガラス板5)に100%転移させる工程でインキ3の凝集力がシリコーンゴムとインキ3の界面張力より大きければ、インキ3は100%転移になり(図4参照)、たとえば転移工程でインキ3の凝集力がシリコーンゴムとインキ3の界面張力より小さい場合は、インキ3の中間で破壊され破壊転移となる(図3参照)。なお、図中の符番5はガラス板である。

【0012】そこで、インキの受理工程と反対にインキの転移工程でインキ温度を低温にすることにより、シリコーンゴムとインキの界面張力よりインキの凝集力の方が大きくなり100%転移となる。そして、溶剤を添加しないため、シリコーンゴムの膨潤も無く、長時間に渡って印刷しても初期印刷物と変らない印刷物が得られる

【0013】また、インキ粘度を非常に高くしてインキ 3をガラス板5に転移できるのでストライプのニジミ出 し、糸引きによるヒゲ等が無くなり、ストライプの形状 が溶剤型インキで印刷した形状(図5参照)がカラーフ ィルターに求められる形状(図6参照)の理想的な形状 に近づき、品質の良いストライプを印刷することができ る。また、重ね刷をする時、前に印刷されたストライプ のインキ粘度が高いため形状を変形させなくて済み、カ ラーフィルターの印刷としては非常に良い印刷方法であ る。このように、受理工程でインキ温度を室温より高く し、インキとシリコーンゴムブランケットの界面張力よ りインキの凝集力を小さくして、シリコーンゴムブラン ケットにインキを受理させる工程と、転移工程でインキ 温度を室温又は、室温より低くしインキとシリコーンゴ 30 ムブランケットの界面張力をインキの凝集力より大きく して、インキをガラス等の基盤に転移させる工程におい てインキの温度差をつけて印刷する方法を、以下インキ 温度差印刷法と言う。この場合のシリコーンゴムブラン ケットの温度は、室温あるいはインキの温度特性によっ て室温以下にするとインキの受理、転移が良好になる。 【0014】とのように、インキ温度差印刷法でストラ イプ印刷を行えば、無溶剤型インキでインキの100% 転移が出来、溶剤でのシリコーンゴムの膨潤も無くな り、初期の印刷物の品質と長時間印刷した時の印刷物の 品質と同じ品質が保たれる。又、高粘度インキをガラス 等の基盤に転移できるのでストライプのニジミ出し、糸 引きによるヒゲ等が無くなりストライプ形状が理想的な 形状(図6参照)に非常に近き、品質の良いカラーフィ ルターを作成することが出来、その結果、液晶ディスプ レーに組込んで作動させると非常に良好なコントラス ト、画質を得ることができる。

[0015]

【作用】との発明のインキ温度差印刷法は、インキ受理 できた。同様に、インキ温度、凹版温度を室温の24℃ 工程では、インキ温度を高温にして(インキの凝集力< 50 で印刷試験を行った所、インキがシリコーンゴムブラン

シリコーンゴムとインキの界面張力)、インキの受理を良くする。また、次の転移工程では、インキ温度を低温にして(インキの凝集力>シリコーンゴムとインキの界面張力)無溶剤インキでも100%転移を容易にすることができる。

[0016]

【実施例】以下、この発明の実施例について説明する。 (実施例1)印刷用ゴムブランケットは、圧縮層11にク ロロプレンスポンジゴムの硬度40°(アスカーC 型)、厚さ1.0mmを使用し中間にスタビライザー12 としてポリエステルフィルム0. 18mmを接着、表面 ゴム13としてシリコーンゴム(商品名: TSE346 6、東芝シリコーン社製) O. 8 mmの厚さに接着成形 した(図7参照)。表面を鏡面にするため、鉄板をクロ ムメッキしてシリコーンゴムが硬化する前にクロムメッ キした鉄板に密着させて表面粗さ 0.5μm (Rz)以 下の表面状態を持った印刷用ゴムブランケットを得た。 【0017】インキは、顔料、ビヒクル、界面活性剤、 ゲル化剤、ワックスで図8のBの温度特性を持った無溶 20 剤型のインキを作成した。なお、図8において、Bイン キは受理と転移の温度差が小さくて良い(ワックスイン キ)。また、Cインキは受理と転移の温度差を大きくし なければ100%転移にならない(100%転移インキ として理想的でない)。更に、AインキはBインキとC インキの中間的と言える(顔料配合量で高粘度にし

【0018】印刷試験は平台の構成機を使用して、印刷 工程は下記の方法で行った。

(1).インキを60℃に保温。

) (2).凹版を60℃に保温。

【0019】(3).上記(1) のインキを(2) の凹版に充填、ドクターナイフで余分なインキを掻き取る。

(4).60 °Cのまま凹版からインキをシリコーンゴムブランケットに受理する。

【0020】(5).印刷するガラス板を15~20℃位に しておく。

(6).上記(5) のガラス板に上記(4) のインキを受理した シリコーンゴムブランケットを0.4mmの印圧を掛け てインキをガラス板に100%転移させた。

40 (7).上記(6) で印刷されたガラス板を200℃のオーブンに30分間入れて、印刷されたストライプを硬化させた。

【0021】 ことで、凹版は線幅50μm、深さ10μmのストライブを使用した。以上の条件で印刷した結果、無溶剤インキでもインキは100%転移され、ストライブの形状は理想的な(図6参照)のような形状に近く印刷された。これを液晶ディスプレーに組込んで作動させると非常に良好なコントラスト、画質を得ることができた。同様に、インキ温度、凹版温度を室温の24℃で印刷試験を行った所、インキがシリコーンゴムブラン

ケットに少量しか受理されず、次のインキ転移工程を行 うことができなかった。

【0022】(実施例2)シリコーンゴムブランケット は、実施例1で使用したものを使った。インキは、図8 のBインキのワックスを抜いて顔料の配合量をコントロ ールして、図8のAインキの温度特性を持った無溶剤型 のインキを作成した。印刷試験は実施例1同じ構成機を 使用して、印刷工程は下記の方法で行った。

【0023】(1).インキを60℃に保温。

- (2).凹版を60℃に保温。
- (3).上記(1) のインキを上記(2) の凹版に充填、ドクタ ーナイフで余分なインキを掻き取る。

【0024】(4).60℃のまま凹版からインキをシリコ ーンゴムブランケットに受理する。

(5).印刷するガラス板を5~10℃位に冷却しておく。

(6).上記(5) のガラス板に上記(4) のインキを受理した シリコーンゴムブランケットを0.4mmの印圧を掛け てインキをガラス板に100%転移した。

【0025】(7).上記(6) で印刷されたガラス板を20 0℃のオープンに30分間入れて、印刷されたストライ 20 インキ温度を上げることによってシリコーンゴムとイン ブを硬化させた。

ここで、使用した凹版は、線幅50μm、深さ10μm のストライプを使用した。以上の条件で印刷した結果、 無溶剤インキでもインキは100%転移され、ストライ プの形状は理想的な(図6)のような形状に近く印刷さ れた。これを液晶ディスプレーに組込んで作動させると 非常に良好なコントラスト、画質を得ることができた。 また、同様にインキ温度、凹版温度を室温の24℃で印 刷試験を行ったところ、インキがシリコーンゴムブラン うことができなかった。

【0026】(実施例3)シリコーンゴムブランケット は実施例1で使用したものを使った。インキは、図8の Aインキの顔料配合量を少なくし、Cインキの温度特性 を持った無溶剤型のインキを作成した。印刷試験は、実 施例1同じ構成機を使用して、印刷工程は下記の方法で 行った。

【0027】(1).インキを60℃に保温。

- (2).凹版を60℃に保温。
- ーナイフで余分なインキを掻き取る。

【0028】(4).60℃のまま凹版からインキをシリコ ーンゴムブランケットに受理する。

- (5).印刷するガラス板を0℃位に冷却しておく。
- (6).上記(5) のガラス板に上記(4) のインキを受理した シリコーンゴムブランケットを0.4mmの印圧を掛け てインキをガラス板に100%転移した。

【0029】(7).上記 (6)で印刷されたガラス板を20 0℃のオーブンに30分間入れて、印刷されたストライ プを硬化させた。

ととで、使用した凹版は線幅50μm、深さ10μmの ストライプを使用した。

【0030】以上の条件で印刷した結果、無溶剤インキ でもインキは100%転移され、ストライブの形状は理 想的な(図6)のような形状に近く印刷された。これを 液晶ディスプレーに組込んで作動させると非常に良好な コントラスト、画質を得ることができた。また、同様に インキ温度、凹版温度を室温の24℃で印刷試験を行っ たところ、インキがシリコーンゴムブランケットに少量 10 しか受理されず、次のインキ転移工程を行うことができ なかった。

#### [0031]

【発明の効果】以上詳述したようにこの発明によれば、 凹版オフセットの100%転移印刷で凹版からシリコー ンゴムブランケットにインキを受理する工程と、インキ を受理したシリコーンゴムブランケットからガラス等の 基盤にインキを転移する工程でインキの温度差を付ける ことで無溶剤インキでもガラス等の基盤にインキを10 0%転移することができる。これは、インキ受理工程で キの界面張力よりインキの凝集力を小さく出来、シリコ ーンゴムブランケットに必要十分なインキを受理すると とができるためである。

【0032】また、インキ受理工程でインキ温度を上げ るのでインキの高粘度のものを使用することが出来、印 刷されたストライブの品質を上げることが出来る。具体 的にはストライブの直線性が良くなり、ストライブのヒ ゲ、気泡等が無くなる。更に、インキ転移工程では低温 にしてインキが転移されるのでインキの粘度が上がり、 ケットに少量しか受理されず、次のインキ転移工程を行 30 インキの凝集力がシリコーンゴムとインキの界面張力よ り大きくなり100%転移が行われ易い。

【0033】そして、髙粘度又はワックス状でガラスに インキが転移されるため、ストライプの形状が理想的な (図6)の形状に近いストライプとなり、ストライプの 高さも安定してくる。このように、インキ温度差印刷法 で印刷されたストライプは、溶剤型インキで印刷された ストライプより非常に髙品質であり、このカラーフィル ターを液晶ディスプレーに組込んで作動させると良好な コントラストと高品質な画質を得ることができた従来の (3).上記(1)のインキを上記(2)の凹版に充填、ドクタ 40 欠点(具体的には、耐刷性が悪い、ストライプの品質が 悪い,インキの選択幅が狭い)を、インキ温度差印刷法 の印刷方法を採ることによって克服することが出来た。

【図面の簡単な説明】

【図1】凹版からシリコーンブランケットへのインキ受 理工程の説明図。

【図2】ガラス基盤からシリコーンブランケットへのイ ンキ転移工程の説明図。

【図3】ガラス基盤からシリコーンブランケットへのイ ンキ転移工程における破壊転移の説明図。

50 【図4】ガラス基盤からシリコーンブランケットへのイ

ンキ転移工程における100%転移の説明図。

【図5】溶剤型インキで印刷したストライプの断面形状の説明図。

【図6】理想とされるストライプの断面形状の説明図。

【図7】印刷に使用したシリコーンゴムブランケットの断面図。

【図8】各種のインキにおけるインキ粘度とインキ温度\*

\* との関係を示す特性図。

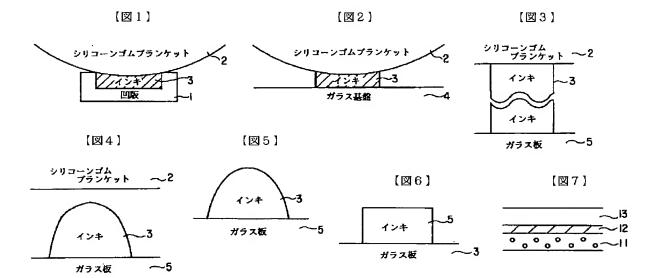
【符号の説明】

1…凹版、 2…シリコーンゴムブランケット、3…インキ、4…ガラス基盤、 11…圧縮層、

8

12…スタビライザー、13…シリコーンゴ

ム。



【図8】

